

第三届集成电路产业技术创新奖实施方案

一、指导思想：

通过集成电路产业技术创新奖（简称“IC创新奖”）的申报、评选、颁布等过程活动，鼓励创新、引导并加强产业链合作、加速创新成果产业化，营造全产业链合作发展的良好局面。

二、奖项定位：

IC创新奖重点鼓励集成电路技术创新、成果产业化、产业链上下游合作，以体现大联盟倡导全产业链合作的理念。

三、奖项类别：

1. **技术创新奖：**表彰在集成电路重大技术创新和关键技术开发方面取得重大突破的单位和团队。
2. **成果产业化奖：**表彰在集成电路创新成果产业化推进和市场拓展方面取得突出业绩的单位和团队。
3. **产业链合作奖：**表彰在推进集成电路产业链上下游及产学研合作方面做出贡献的单位和团队。
4. **产业创新突出贡献奖：**表彰在集成电路技术创新、成果产业化、产业链合作等方面做出贡献的个人。

四、奖项产生：

1. **奖项申请：**单位申报与专家提名相结合。
 - (1) 大联盟及各专业联盟成员单位、重大专项项目承担单位、以及其他集成电路行业单位申报（填写申报表）。
 - (2) IC创新奖提名委员会专家提名。
2. **奖项受理：**大联盟秘书处受理申报材料，并对申报材料的完整性进行审查。参加评选的单位填写第三届集成电路产业技术创新奖申报表（附件1），由单位负责人签字并加盖公章后，于

11月30日前将纸质材料原件一式一份快递至大联盟秘书处，同时将电子版申报表（Word版和PDF扫描版）发送至秘书处联系人邮箱。

联系人：李振山

邮 箱：lizhenshan@ictia.cn

电 话：010-82997023

手 机：13810428215

地 址：北京市朝阳区北土城西路3号中科院微电子所

3. **奖项评选：**大联盟组织评审委员会对申报项目进行评审，并于2019年12月底前最终形成各奖项评选结果。

五、奖项发布：

1. 第三届IC创新奖将在大联盟2020年度大会上向各获奖单位、团队及个人颁发。
2. 获奖名单将同时在大联盟网站（www.ictia.cn）、各专业联盟网站以及行业权威媒体上公布。